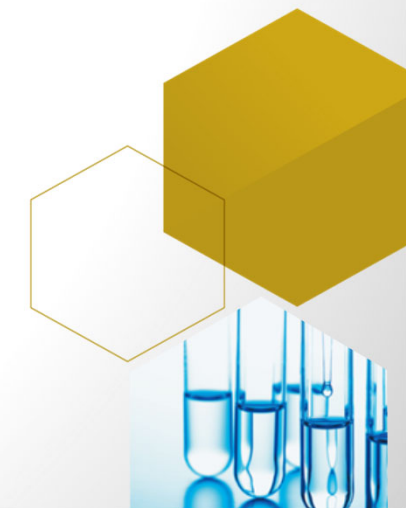
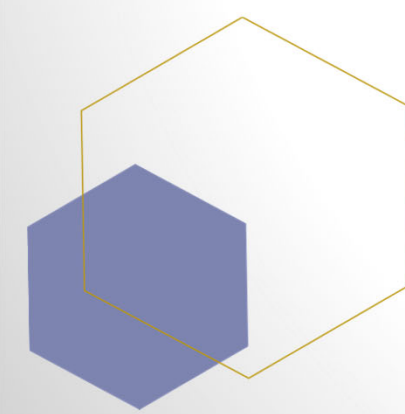





2021年3月期 決算説明資料



 日本高純度化学株式会社

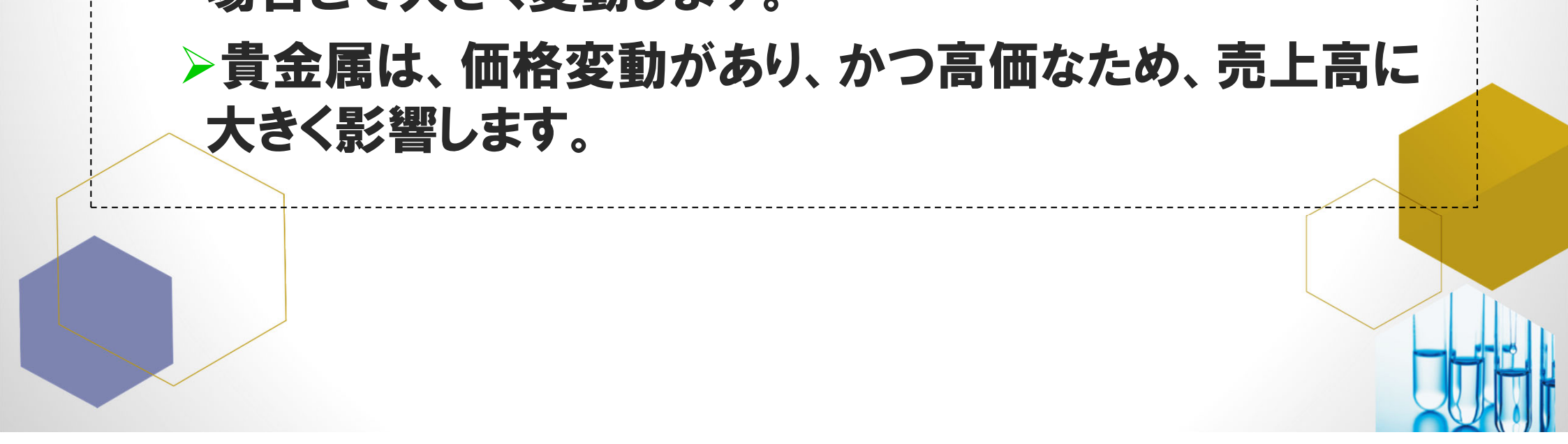
証券コード: 4973

2021年4月23日



決算の概況

(注)当社業績の見方のポイント

- 売上高は、薬品と一緒に貴金属を売る場合と、売らない場合とで大きく変動します。
 - 貴金属は、価格変動があり、かつ高価なため、売上高に大きく影響します。
- 

2021年3月期の概況

電子部品業界の状況

- 5G(第5世代移動通信システム)対応スマートフォンの拡大、リモートワークや巣ごもり生活に伴うパソコン需要の増大による下支えもあり、コロナ禍の影響は限定的となった。
- 期前半にコロナ禍の影響を受けた車載用電子部品については、期後半に持ち直してきたが、寒波による電力不足や火災事故も重なり、期末には車載用半導体不足が自動車の生産調整に影響する事態となった。

当社決算の概況

- 急速に拡大した5G対応スマートフォンの需要に支えられプリント基板・半導体搭載基板用めっき薬品の販売が堅調に推移した。
- コネクタ用めっき薬品の販売も、5G対応スマートフォンの需要拡大に支えられて堅調に推移したが、期初のコロナ禍の落ち込みを補うには至らなかった。
- リードフレーム用めっき薬品の販売は貴金属パラジウム価格の高騰を受けて引き続き売上げに寄与した。

2021年3月期 決算概況

(単位:百万円、%)

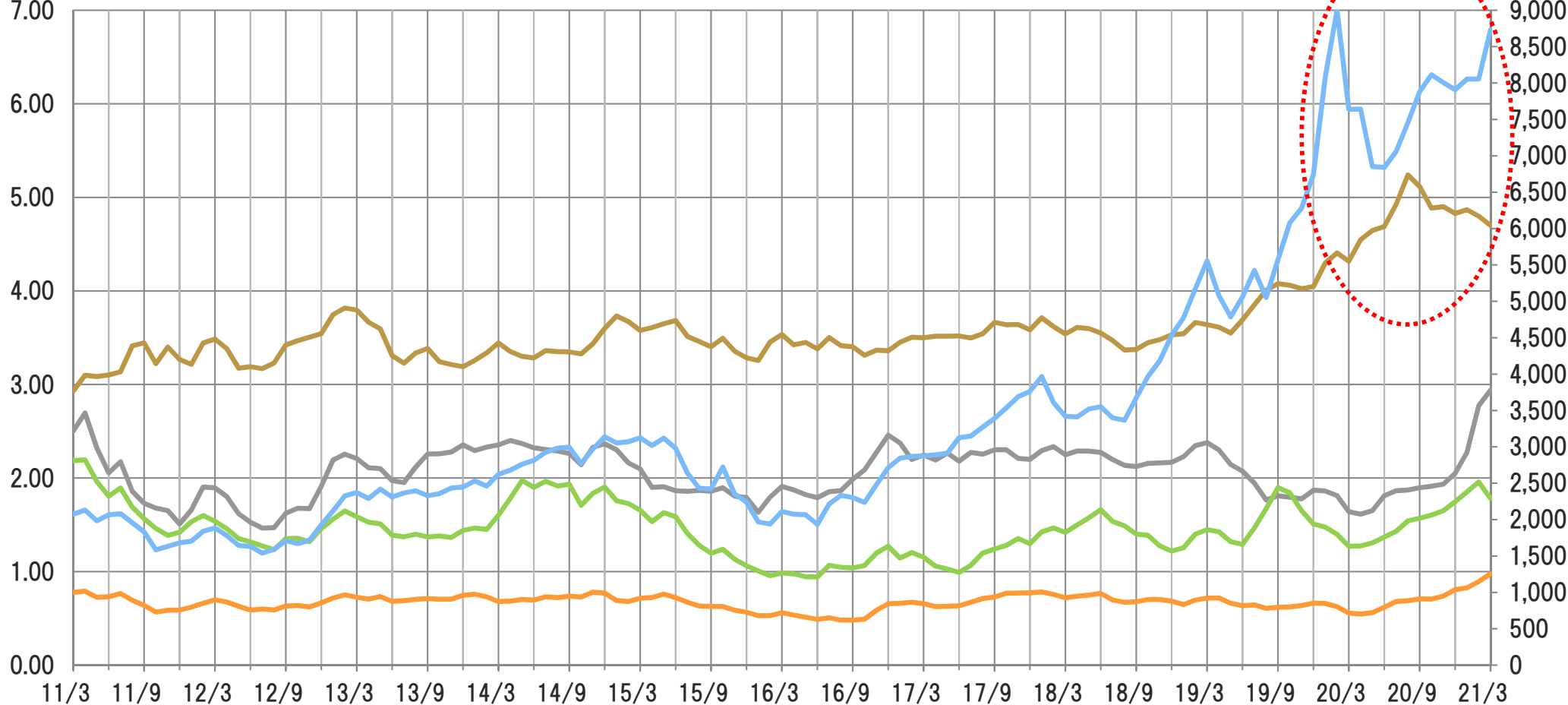
	2020/3期	2021/3期						2021/3期予想	
		1Q	2Q	3Q	4Q	通期合計	増減率	達成率	
売上高	12,969	3,891	3,828	4,484	4,417	16,622	28.2	15,000	110.8
営業利益	1,034	179	225	306	243	955	▲7.7	880	108.6
経常利益	1,165	233	230	356	248	1,069	▲8.2	1,000	107.0
純利益	858	170	175	267	176	790	▲7.9	730	108.3
1株当たり 当期純利益	148.58円	29.56円	30.35円	46.17円	30.43円	136.53円	—	126.08円	—

メタル相場推移

Prices of copper, tin and nickel
銅、スズ、ニッケル価格

Copper 銅 Tin スズ Nickel ニッケル

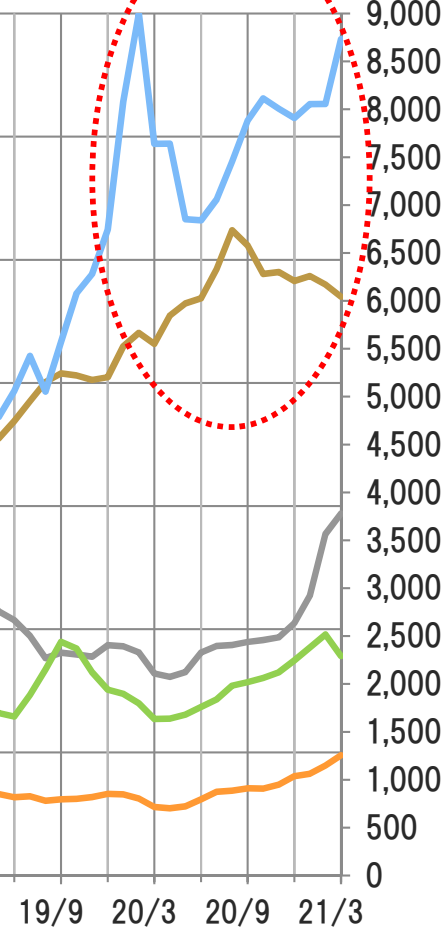
(yen/g)
(円/g)



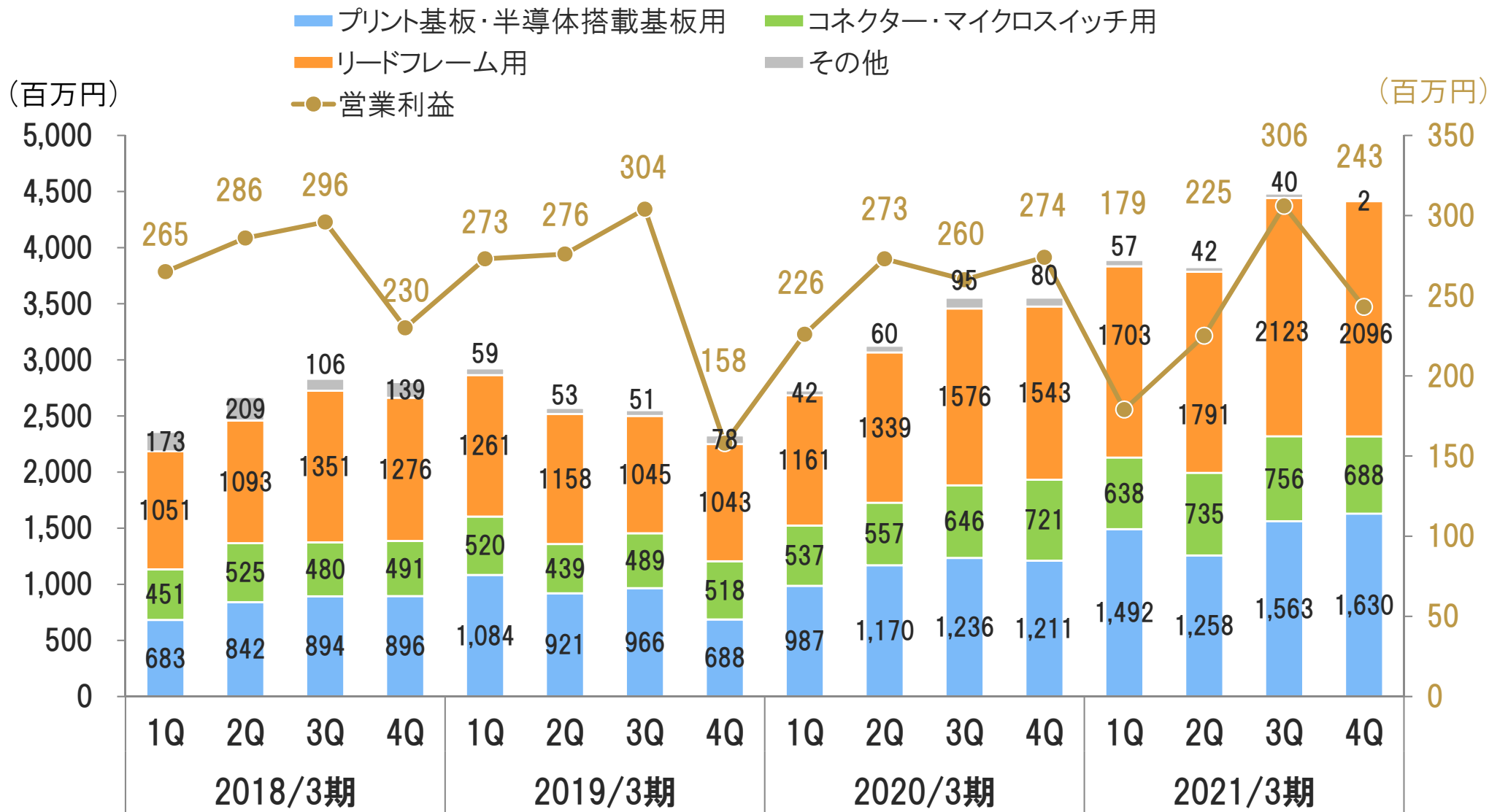
Prices of gold and palladium
金、パラジウム価格

Gold 金 Palladium パラジウム

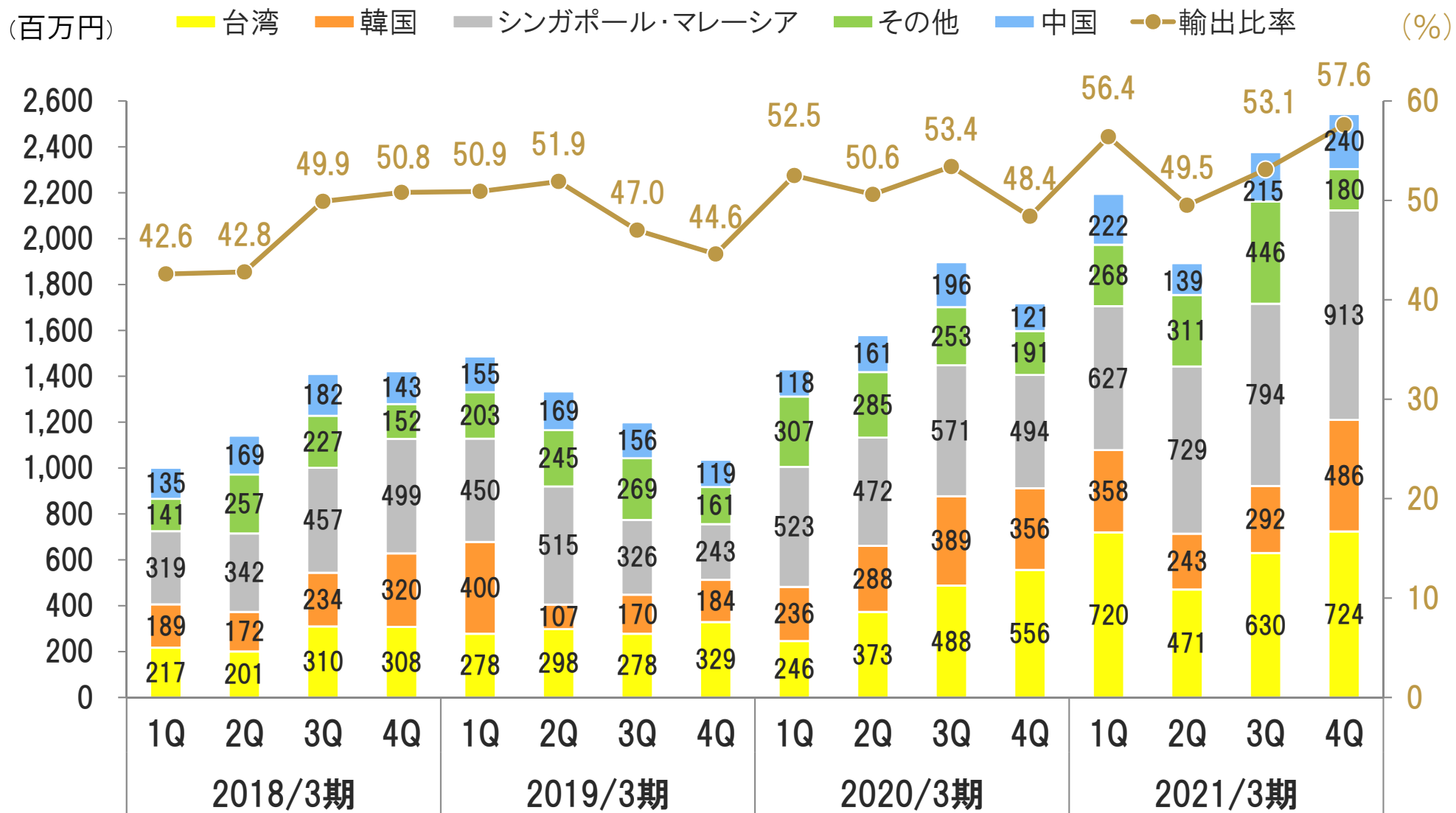
(yen/g)
(円/g)



売上高・営業利益の推移(四半期ベース)



輸出地域別売上高の推移(四半期ベース)

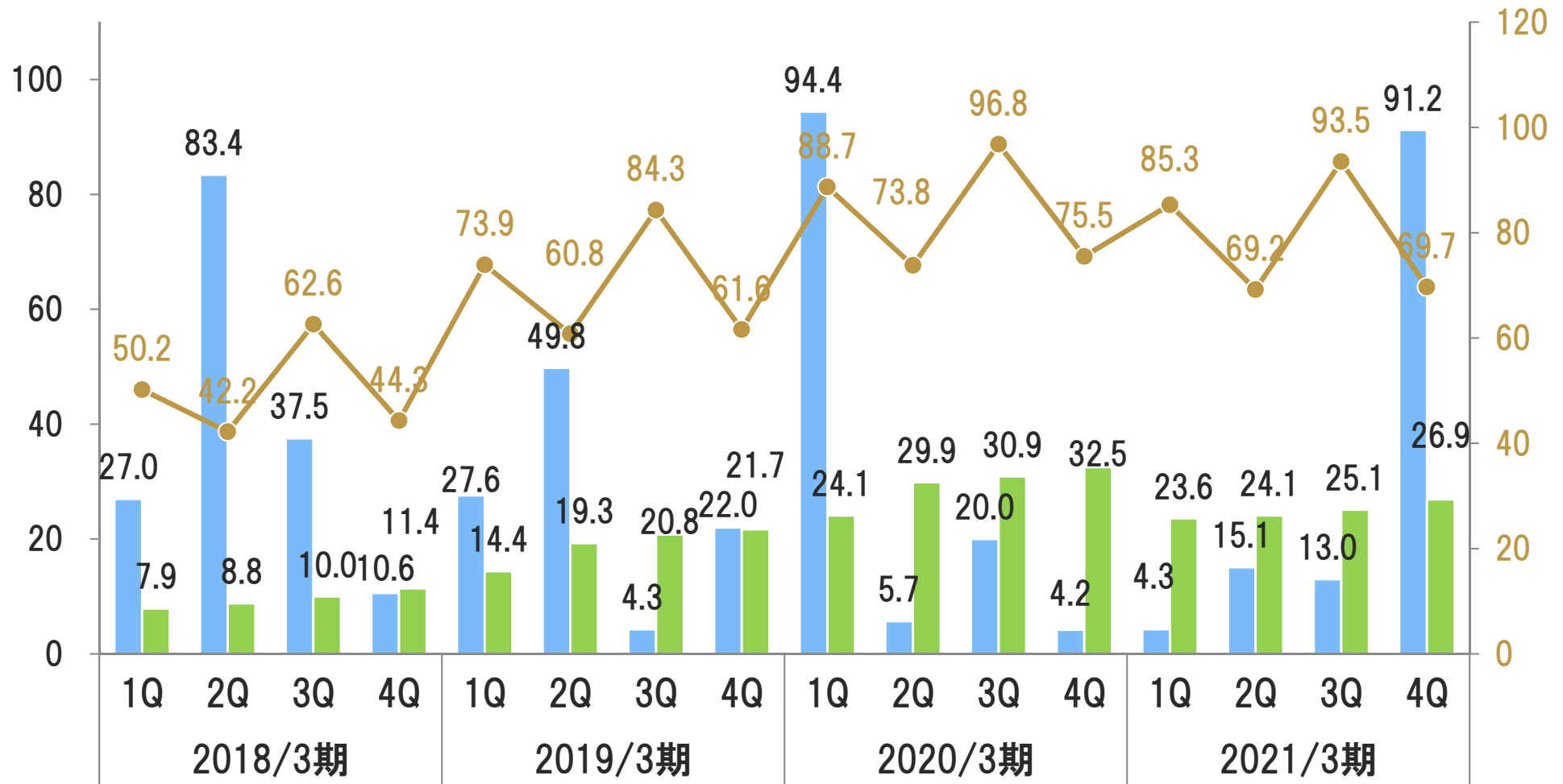


設備投資額、減価償却費および研究開発費の推移

(百万円)

■ 設備投資額 ■ 減価償却費 ● 研究開発費

(百万円)



次期の見通し

(単位:百万円、%)

	2021/3期			2022/3期		
		構成比	前期比		構成比	前期比
売上高	16,622	100.0	28.2	17,000	100.0	2.3
営業利益	955	5.7	▲7.7	1,090	6.4	14.1
経常利益	1,069	6.4	▲8.2	1,200	7.1	12.2
当期純利益	790	4.8	▲7.9	870	5.1	10.1

トピックス

- **硬質金(金合金)**・・・マイクロコネクタ用硬質金めっき薬品を拡販中
- **DIG(銅上ダイレクト金)**・・・ENIGに代わる高周波特性・高解像度対応プロセスとして拡販中
- **EPIG(銅上ダイレクトパラジウム/金)**・・・巨大なIoT市場に展開できるよう、技術・営業両面でフォロー中

いずれも業界動向や顧客ニーズに迅速に対応できるよう積極的に拡販活動をおこなっております。

配当について

(単位:円、%)

	通期	1株当たり 当期純利益	配当性向
2017/3期	80	124.44	64.3
2018/3期	80	144.13	55.5
2019/3期	80	146.36	54.7
2020/3期	80	148.58	53.8
2021/3期	80	136.53	58.6
2022/3期(予想)	80	150.08	53.3

ESG/SDGsへの取り組み

当社のめっき薬品は、電子部品業界で広く使われ、近年ではスマートフォン市場に留まらず、電動化・電装化が進む自動車市場、IoT化が進む産業機械市場など、幅広い分野へ進出しております。

今後も事業を通じてESG/SDGsに関する取り組みを進めてまいります。

●環境に配慮し、貴金属資源の有効活用につながる製品を顧客に訴求

- ・貴金属使用量を減らすことのできる省金めっき薬品を顧客に提供

●社会貢献活動の促進






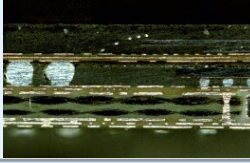
- ・JPC奨学財団を設立・運営し、36名の大学生・大学院生へ奨学金支給を支援



●コーポレートガバナンスの強化

- ・取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置 (2019年6月)
- ・英文招集通知及び議決権電子行使を導入 (2020年6月)

製品ラインアップ ~ラインアップ拡充と新分野開拓~

めっき方式		用途	製品ラインアップ	
電解	純金		① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき	
	硬質金 (合金)		マイクロコネクタ用省金硬質金めっき オーロブライト BAR7	
	電解Pd		PPF用薄膜パラジウムめっき パラブライト NANO2	
無電解	置換金		中～高リンニッケルで使える置換金めっき 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき	IM-GOLD IB2X IM-GOLD CN
	還元金		亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき シアン化金を使った薄膜還元金めっき	HY-GOLD HY-GOLD CN
	還元Pd		ENEPIG用還元パラジウムめっき ダイレクト還元パラジウムめっき	ネオパラブライト 2 ネオパラブライト DP
新分野			卑金属(銅、スズ、ニッケル) 合金めっき 後処理剤など	

今後の展開

① 当社貴金属めっきシェアを拡大



新用途のキャッチアップ

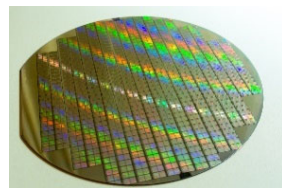
② 当社があまり手を付けてこなかった 貴金属めっき市場を開拓



海外車載コネクタ需要のキャッチアップ

③ 半導体・先端パッケージ開発に対応する めっき技術への挑戦

★ 貴金属めっきで培ったユニークな技術を他のめっき技術に展開



有機基板から
ウェハー、先端パッケージへ

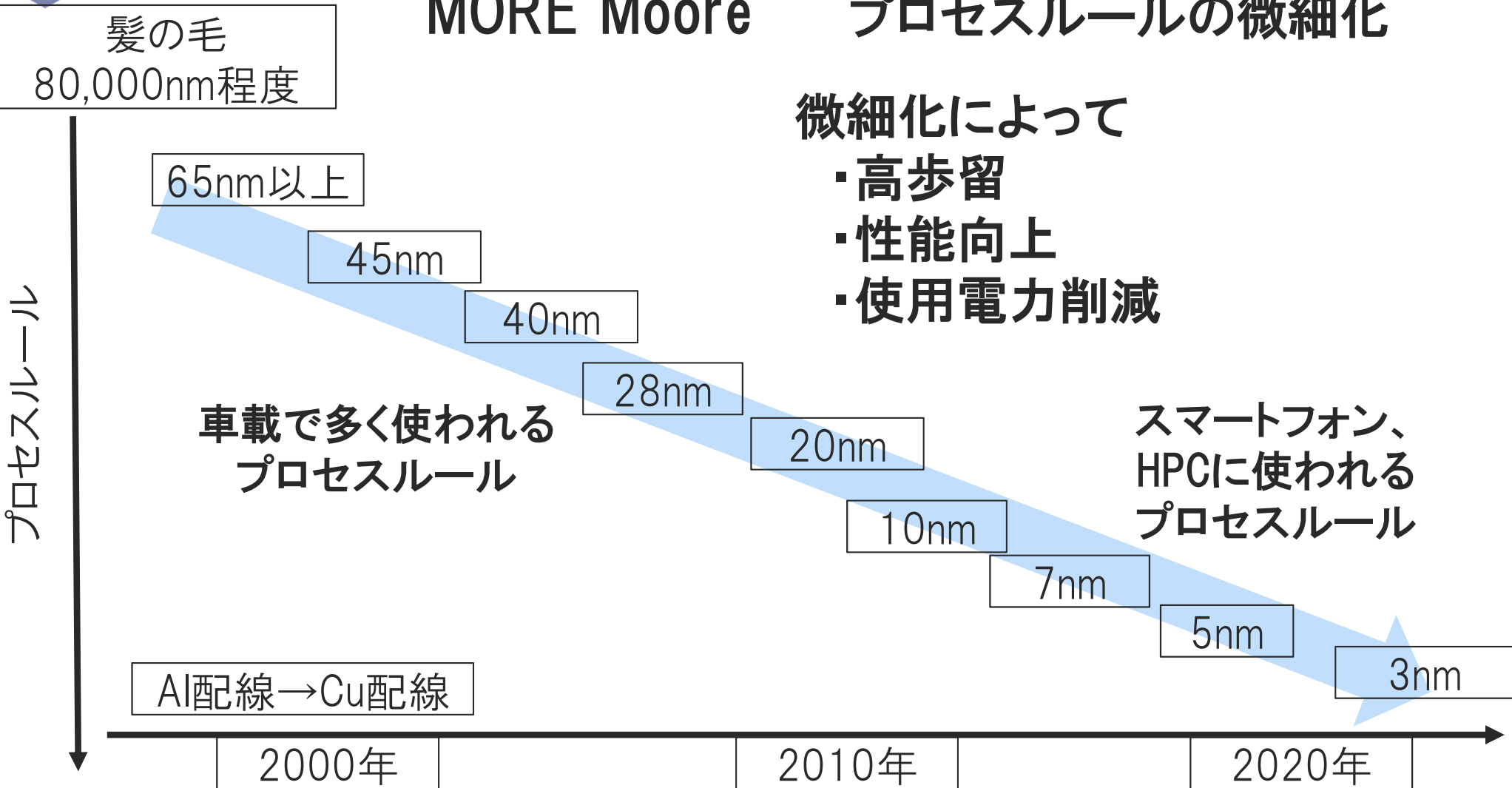
新たなパッケージ仕様への要求を掴む

MORE Moore

プロセスルールの微細化

微細化によって

- ・高歩留
- ・性能向上
- ・使用電力削減



製造設備投資が大きくなり微細化が難しい

新たなパッケージ仕様への要求を掴む

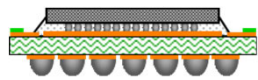
More than Moore パッケージ高密度化

パッケージ技術は様々な仕様を生み出しながら高密度化し、ムーア則を上回る単位面積当たりのトランジスタ数を実現し、更にChiplet化による歩留まり向上も実現しようとしている。

RDL
(Re distribution layer)
技術との融合

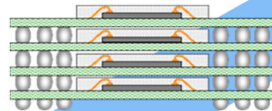
更なるシステム
モジュールへ

サーバーCPU
車載SoCなど



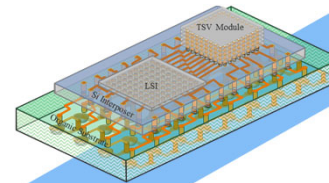
FC BGA/LGA

モジュール



PoP

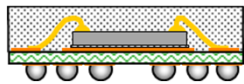
メモリー
イメージセンサ
2.5D、3Dパッケージ



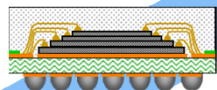
2.5D 3D

高密度パッケージ技術への
高まる要求

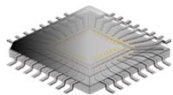
車載
メモリーなど



WB BGA BOC



MCP



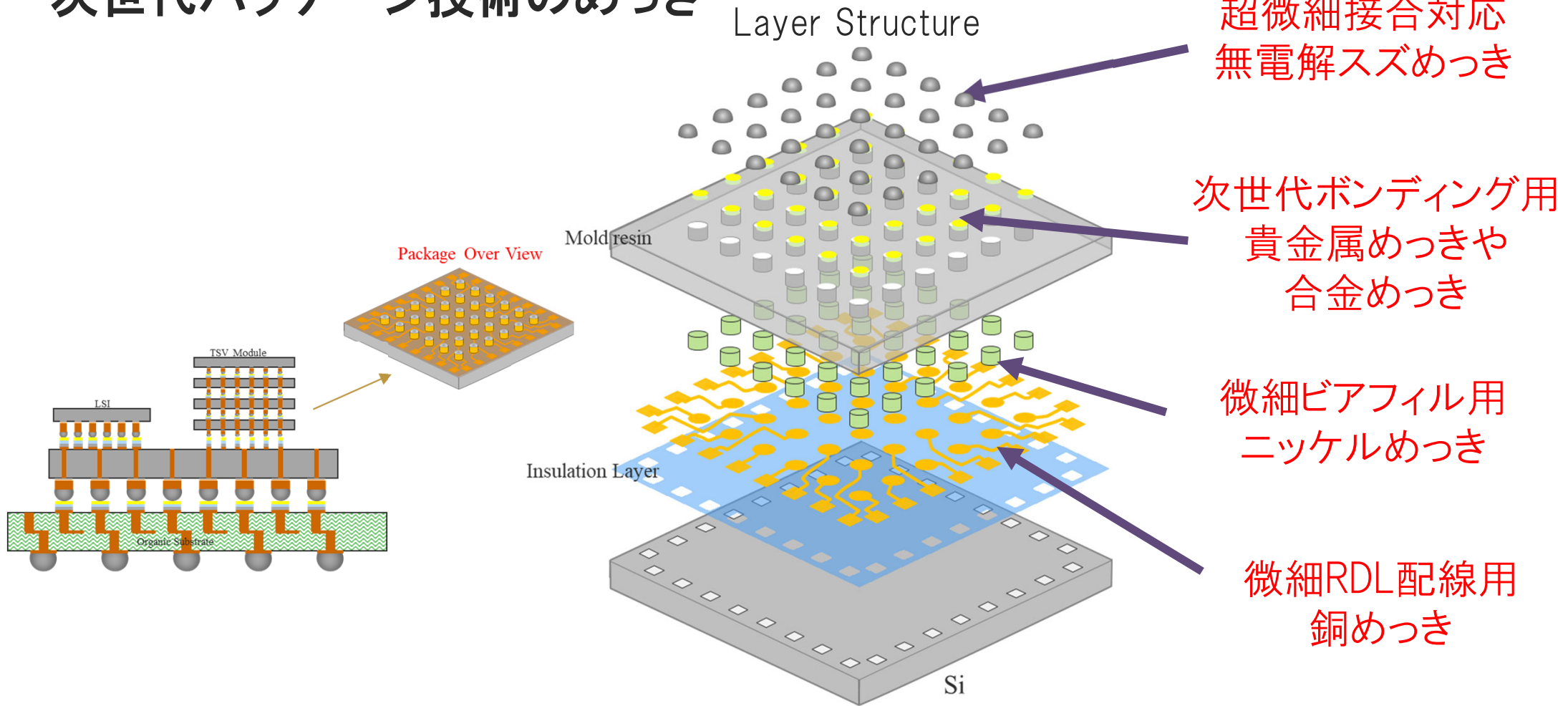
QFP

新たなRDL技術、接合技術に要求される 課題を捉える

新たなパッケージ仕様への要求を掴む

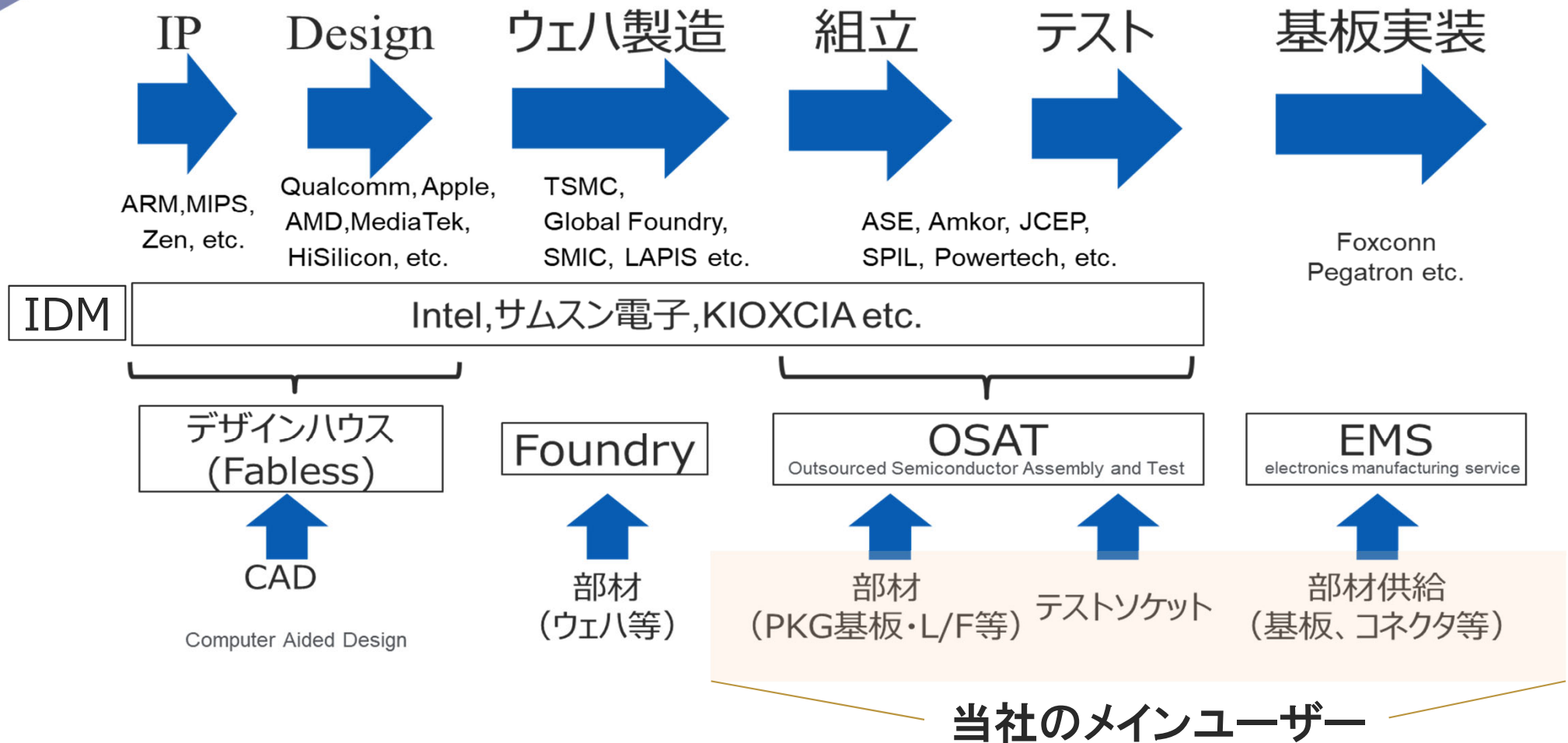
More than Moore

次世代パッケージ技術のめっき



新たなRDL技術や微細接合技術に要求されるめっき技術に挑戦

新たなパッケージ仕様への要求を掴む



IDM, Foundry, OSAT, PKG基板メーカーなどがそれぞれの特徴を生かして新たなPKG技術に挑戦する中、新たなめっき技術が求められている。当社はこの技術的要求を捉えて新たなユーザー獲得を目指す。



注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2021年3月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>

補足資料： 会社紹介

沿革

- 1971年7月 会社設立
- 1999年11月 MBOを実施
- 2002年12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年3月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年3月 東京証券取引所市場第一部に指定
- 2019年2月 一般財団法人JPC奨学財団設立
- 2020年4月 公益財団法人JPC奨学財団に認定

事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき工程に絞り世界シェアトップ
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを必要としないファブレス企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献